

## “レーザーおよびレーザー援用加工の新展開”

開催日 平成 30 年 3 月 16 日(金)

主催：公益社団法人精密工学会

企画：中部大学生産技術開発センター（センター長：中部大学 教授 鈴木 浩文）

協賛：精密工学会東海支部，レーザー学会，レーザー加工学会，レーザー協会，応用物理学会，日本機械学会，日本塑性加工学会，電気加工学会，砥粒加工学会

趣旨：1960 年のレーザー誕生から半世紀余が経過し，レーザーは計測・通信・記録・表示・診断・治療・核融合のほか，切断・溶接・熱処理・表面処理・露光などの加工の分野でも広く利用されるようになった。炭酸ガスレーザーと YAG レーザによる切断・穴あけと溶接が主要なレーザー加工技術であるが，最近ではファイバーレーザーや半導体レーザーなどの新しいレーザーの出現や新しいレーザー加工技術の誕生が国内外であり，益々その応用分野が広がっている。今回のシンポジウムでは，将来への発展を見据えた話題を集めました。新しいレーザー加工の動向を知る良い機会だと思います。公開シンポジウムとして無料での開催としましたので，関係各位の積極的なご参加を期待しています。

開催日時：平成 30 年 3 月 16 日(金)午前 9 時より

会場：中央大学後楽園キャンパス（東京都文京区春日 1-13-27）

5 号館 2 階 5234 号室（講演室 B）

※ 東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩 5 分，都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩 6 分，JR 中央・総武線『水道橋駅』から徒歩 12 分

使用言語：日本語と英語(海外からの講師の場合)

参加費：無 料

※ 聴講ご希望の方は開催当日，直接会場へお越しください。

ただし，資料集は大会シンポジウムと合冊にて春季大会受付で販売いたします。

プログラム：

- 9:00～ 9:05 “ はじめに ”  
中部大学 鈴木 浩文 氏
- 9:05～9:40 “ レーザ加工の最新動向 — ものづくりの中のレーザー加工 — ”  
中央大学 新井 武二 氏
- 9:40～10:20 “ Precision Laser Assisted Diamond Turning of Hard-to-Machine Materials ”  
Micro-LAM Inc. Deepak Ravindra 氏  
(10:20～10:35 休 憩)
- 10:35～11:15 “ 超短パルスによる非金属材料のレーザー接合 ”  
岡山大学 岡本 康寛 氏
- 11:15～11:55 “ 高輝度青色半導体レーザーの開発とアディティブマニュファクチャリングへの展開 ”  
大阪大学 塚本 雅裕 氏  
(11:55～13:00 昼 食)
- 13:00～13:40 “ Micro Processing with High Average Power Ultrafast Laser ”  
トルンプ株式会社 中村 洋介 氏
- 13:40～14:20 “ 新しいレーザー切断プロセス KABRA ”  
株式会社 ディスコ 平田 和也 氏
- 14:20～14:25 “ おわりに ”  
中部大学 難波 義治 氏
- 14:35～15:30 技術交流会

詳細問合せ先：公益社団法人精密工学会 大会係

〒102-0073 東京都千代田区 1-5-9 九段誠和ビル 2 階

E-mail : jspe\_taikai@jspe.or.jp 電話 : 03-5226-5191